

Presseinformation

2016/10/28

Live-Vorführungen und Präsentationen rund um Henkels führende Position im Bereich Elektronikmaterialien

Henkel präsentiert neue und bewährte Materialien zur Elektronikfertigung auf der Electronica 2016

Elektronikprodukte müssen immer höhere technische Anforderungen und Standards erfüllen. Neben der hohen Qualität und Zuverlässigkeit spielt auch die Kosteneffizienz eine zentrale Rolle. Auf der Electronica Messe in München stellt Henkel deshalb sein breites Produktportfolio für geräteschutzrobustes Wärmemanagement sowie zuverlässige Verbindungen vor. In Halle B1 am Stand 361 erfahren Besucher mehr über den modernen Schutz von bestückten Leiterplatten, Wärmemanagement und Lötmaterialien. Zudem können sie sowohl an Hands-on-Vorführungen, als auch an technischen Präsentationen im Ausstellerforum teilnehmen und hier neueste Produktentwicklungen mit den Spezialisten von Henkel besprechen.

Lösungen für den Schutz von Leiterplatten

Für die dauerhafte Zuverlässigkeit von Produkten spielt der Schutz von bestückten Leiterplatten eine entscheidende Rolle. Henkels umfangreiches Angebot in diesem Bereich geht über den Schutz hinaus und bietet zusätzlich auch funktionale Eigenschaften. Mit Technomelt TC 50 bietet das Unternehmen nun auch einen wärmeleitenden Hotmelt, der im einfachen und kostengünstigen Low-pressure Moldverfahren appliziert wird. Die im Betrieb entstehende Verlustwärme wird entsprechend durch das Moldmaterial verteilt und an die Umgebung abgegeben. Damit kann eine Überhitzung der Schaltung vermieden und die Zuverlässigkeit sowie die Lebensdauer erhöht werden. Live-Demos mit Technomelt TC 50 finden am Stand von Henkel statt. (www.technomelt-simply3.com)

Als weitere Hotmelt Innovation bietet TECHNOMELT AS 8998 eine automatisierbare Masking-Lösung zur Vereinfachung des Conformal Coating Prozesses. Das Material wird vor dem Lackierungsprozess auf die zu schützenden Bereiche aufgebracht. Ein Aushärtungsschritt ist nicht erforderlich. Nachdem der Beschichtungsprozess



abgeschlossen ist, kann TECHNOMELT AS 8998 einfach wieder abgezogen werden. Ein manuelles Taping oder andere zeit- bzw. kostenintensive Masking-Prozesse erübrigen sich. Dadurch kann der Fertigungsdurchsatz erhöht und der Produktionsprozess vereinfacht werden. Zudem lassen sich die Material- und Arbeitskosten um bis zu 40 Prozent senken. TECHNOMELT AS 8998 ist kompatibel mit Conformal Coating Materialien von Henkel und anderen Herstellern.

Zum Schutz der bestückten Leiterplatten vor Umwelteinflüssen bietet Henkel ein umfangreiches Portfolio an Vergussmassen, die den verschiedensten Anwendungen und Leistungsanforderungen gerecht werden. Dabei stehen sowohl Materialien mit einer sehr hohen Temperaturbeständigkeit oder wärmeleitenden Eigenschaften, als auch Materialien mit geringer spezifischer Dichte oder hoher Beständigkeit gegen chemisch aggressive Medien zur Verfügung.

Robuste Wärmemanagement-Lösungen

Da die Abmessungen der Baugruppen immer kleiner und die Ansprüche an die Funktionalität gleichzeitig immer höher werden, gewinnt das Wärmemanagement zunehmend an Bedeutung. Henkels flüssig applizierbare Gap Filler Materialien sorgen für Konformität bei komplexen Aufbauten und bieten eine automatisierte Lösung für die Serienfertigung. Gap Filler eignen sich für empfindliche Anwendungen, die geringen Belastungen ausgesetzt werden. Die verschiedenen Produkte stehen in zahlreichen Materialzusammensetzungen zur Verfügung, darunter auch der selbstnivellierende Gap Filler 1400SL oder der Gap Filler 3500LV, ein Produkt mit geringer Volatilität.

Besucher am Stand von Henkel haben die Gelegenheit, Gap Filler selbst zu applizieren. Außerdem präsentiert das Unternehmen sein neues GAP PAD HC 5.0, ein äußerst anpassungsfähiges Pad Material mit extrem hoher thermischer Leitfähigkeit, das für geringste Belastungen im betreffenden Aufbau sorgt. (www.henkel-adhesives.com/thermal)

Die nächste Generation der Löttechnologie

Henkels Entwicklungen im Bereich Löttechnologie werden in der Branche hoch geschätzt und ihre Leistungsfähigkeit von Kunden durch Auszeichnungen und Qualifikationen bestätigt. Zudem wurde erst kürzlich das raumtemperaturstabile Material Loctite GC 10 in einer unabhängigen Studie mit drei anderen gängigen Lötpasten verglichen und als Gewinner ausgezeichnet. Sprechen Sie mit den Spezialisten von Henkel über die hohe Prozessstabilität und erfahren Sie mehr über das Kostensparpotential sowie weitere Vorteile dieses Materials. (www.soldergamechanger.com)

Erhalten Sie weitere Informationen von Henkels technischen Experten

Henkels technische Spezialisten präsentieren innovative Produkte und Verfahren auf dem Automotive- und Ausstellerforum der Electronica 2016. Folgende Präsentationen sind geplant:

Ausstellerforum (Halle B5, Stand 343)

Dienstag, 8. November, 15:00 – 15:30

Titel: Hocheffiziente Gap Filler

Sprecher: Holger Schuh, Henkel Liquids Business Development Manager

Automotive-Forum (Halle A6, Stand 328)

Mittwoch, 9. November, 14:30 – 15:00

Titel: Wärmemanagement-Materialien für Batterien

Sprecher: Sanjay Misra, Henkel R&D Direktor für Thermische Produkte

Ausstellerforum (Halle B5, Stand 343)

Donnerstag, 10. November, 12:00 – 12:30

Titel: Die Materialien machen den Unterschied: Thermal Clad – IMS-Laminate

Sprecher: Stefano Sciole, Henkel Business Development Manager IMS

Um einen Termin mit den Materialexperten von Henkel während der Electronica zu vereinbaren, senden Sie eine E-Mail an: electronics@henkel.com. Weitere Informationen über das vollständige Portfolio an Elektronikmaterialien von Henkel finden Sie unter: www.henkel-adhesives.com/electronics.

Alle vorstehenden Marken sind nicht eingetragene und/oder eingetragene Marken der Henkel-Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

Kontakt

Henkel Adhesive Technologies

Ines Behrendt

+49 211 797 - 60 76

electronics@henkel.com

Henkel Corporate Communications

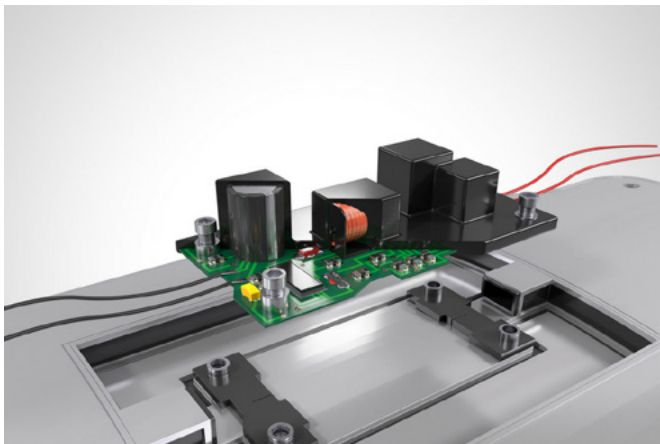
Sebastian Hinz

+49 211 797 – 85 94

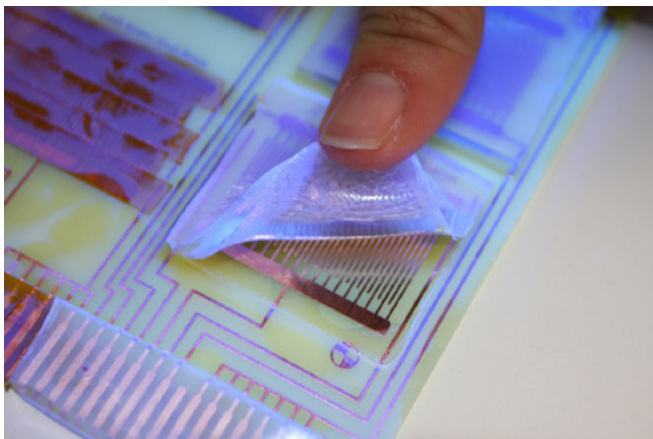
sebastian.hinz@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

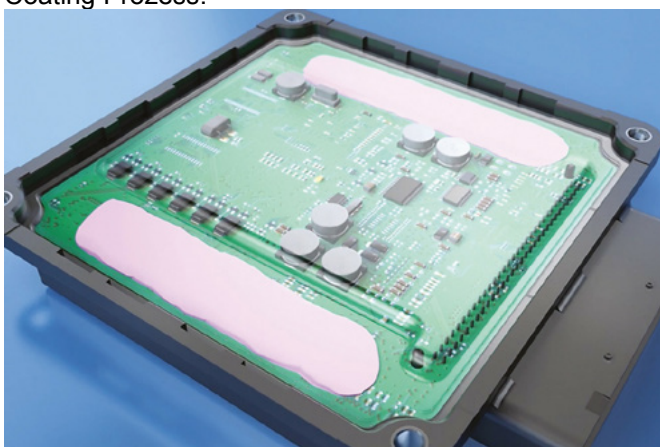
Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Technomelt TC 50 zeichnet sich unter anderem durch seine thermische Leitfähigkeit aus und verteilt entstehende Verlustwärme durch das Moldmaterial.



Technomelt AS 8998 vereinfacht durch seine automatisierbare Masking-Lösung den Conformal Coating Prozess.



Henkels Gap Filler Produkte bieten hervorragende thermische Leitfähigkeit und können flüssig appliziert werden.